



2025年9月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

(開示事項の経過) 当社持分法適用会社(半導体ウエーハ事業)の中国新三板(店頭登録市場)
への登録申請承認に関するお知らせ

株式会社フェローテック(代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」)は、当社の持分法適用会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(以下、「CCMC」)が、中国の店頭取引市場である中国新三板(全国中小企業株式譲渡システム、以下「新三板」)への登録を承認され、2025年9月22日に現地中国にて開示されましたので、開示事項の経過としてお知らせします。

なお、本件に関しては2025年7月3日開示「当社持分法適用会社(半導体ウエーハ事業)の中国新三板(店頭登録市場)への登録申請受理に関するお知らせ」を併せてご参照ください。

記

1. 申請会社の概要(2025年6月30日現在)

(1)	名 称	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 (CCMC)	
(2)	所 在 地	中国浙江省杭州市钱塘新区東塋路 888 号	
(3)	代表者の役職・氏名	法定代表人 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	半導体ウエーハの製造・販売	
(5)	資 本 金	5,032 百万中国元(約 1,048 億円)	※ 1 中国元=20.82 円
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 9 月 28 日	
(7)	当 社 出 資 比 率	23.05%	
(8)	上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当該会社は当社の持分法適用関連会社です
		人 的 関 係	当社の取締役 1 名が同社の董事を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

2. 今後の予定と見通し

CCMC はこれより新三板での CCMC 株式の店頭登録手続きを進め、早ければ 2025 年 10 月より店頭取引される見込みです。なお、当社グループの今期連結業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

3. 備考

本件に関しては、以下の開示を併せてご参照ください。

開示日	表題
2025 年 7 月 3 日	当社持分法適用会社(半導体ウエーハ事業)の中国新三板(店頭登録市場)への登録申請受理に関するお知らせ
2024 年 7 月 4 日	当社持分法適用会社(半導体ウエーハ)の上場申請取り下げに関するお知らせ
2022 年 8 月 30 日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社による上海証券取引所科创板市場への上場申請に関するお知らせ

2021 年 10 月 20 日	当社持分法適用関連会社（半導体ウエーハ事業）による海通証券（主幹事証券）との上場に関するアドバイザー契約の締結、および中国证券监督管理委员会による登録受理のお知らせ
2021 年 9 月 15 日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の第三者割当増資（第二回）の払込完了に関するお知らせ
2021 年 9 月 15 日	（開示事項の訂正・変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回）および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021 年 7 月 15 日	（開示事項の変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回） および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021 年 6 月 30 日	（開示事項の訂正）半導体ウエーハ持分法適用関連会社 の上場に関するお知らせ
2021 年 6 月 29 日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社 の上場に関するお知らせ
2021 年 4 月 15 日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社における第三者割当増資（第二回）、および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021 年 2 月 10 日	半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ
2020 年 11 月 13 日	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資のお知らせ
2020 年 11 月 13 日	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020 年 11 月 5 日	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の株式譲渡代金の払込完了のお知らせ
2020 年 11 月 2 日	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020 年 10 月 19 日	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の株式譲渡代金払込完了のお知らせ
2020 年 10 月 16 日	半導体ウエーハ子会社による第三者割当増資に関するお知らせ
2020 年 9 月 17 日	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ
2020 年 9 月 15 日	半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ

以 上